

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于杭州广立微电子股份有限公司

### 募投项目结项并将节余募集资金进行永久补充流动资金的 核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对广立微募投项目结项并将节余募集资金进行永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币290,000.00万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币21,619.66万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币268,380.34万元，其中超募资金金额为人民币172,823.03万元。募集资金已于2022年8月1日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第392号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，同时公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募

集资金三/四方监管协议》，明确各方的权利和义务。

## 二、募集资金投资项目及募集资金使用计划与调整情况

### （一）首发后原计划募投项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票后，募集资金投资项目资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	集成电路成品率技术升级开发项目	21,542.86	21,542.86
2	集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目	27,506.37	27,506.37
3	集成电路 EDA 产业化基地项目	34,508.09	34,508.09
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		<b>95,557.31</b>	<b>95,557.31</b>

注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

### （二）募投项目金额调整情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，并于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨使用部分超募资金增加投资的议案》，同意公司对募投项目“集成电路成品率技术升级开发项目”和“集成电路 EDA 产业化基地项目”的投资金额进行调整，使用部分超募资金 20,000 万元对其实施追加投资。

前述调整完成后，公司募投项目的最终项目投资金额及拟投入募集资金金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前		调整后		超募资金追加投资金额
		项目投资总额	拟投入募集资金额	项目投资总额	拟投入募集资金额	
1	集成电路成品率技术升级开发项目	21,542.86	21,542.86	27,542.86	27,542.86	6,000.00

2	集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目	27,506.37	27,506.37	27,506.37	27,506.37	-
3	集成电路 EDA 产业化基地项目	34,508.09	43,508.09	48,508.09	48,508.09	14,000.00
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-
合计		<b>95,557.31</b>	<b>95,557.31</b>	<b>115,557.31</b>	<b>115,557.31</b>	<b>20,000.00</b>

注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

### 三、本次结项募投项目资金使用及结余情况

#### （一）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司“集成电路成品率技术升级开发项目”、“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”和“集成电路 EDA 产业化基地项目”已达到预定可使用状态，现予以结项。

截至 2026 年 5 月 31 日，本次结项募投项目资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投资募集资金总额(A)	累计投入募集资金金额(B)	其他变动(C)	募集资金节余金额(D=A-B+C)
集成电路成品率技术升级开发项目	27,542.86	27,375.81	1,187.32	1,354.37
集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目	27,506.37	23,754.46	1,621.22	5,373.13
集成电路 EDA 产业化基地项目	48,508.09	47,570.38	1,746.37	2,684.08
<b>小计</b>	<b>103,557.31</b>	<b>98,700.65</b>	<b>4,554.91</b>	<b>9,411.57</b>

注：1、其他变动包括现金管理收益增加和汇款手续费减少。

2、节余募集资金金额未包含尚未到期的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

3、本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

#### （二）募集资金节余的原因

1、在募投项目实施过程中，公司及子公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在保障项目质量与进度的前提下，本着专款专用、合理、有效的原则，加强了对各项费用的控制，合理配置资金，节省了部分成本。

2、为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入，形成节余募集资金。

#### 四、本次结项募投项目募集资金置换情况

公司于2022年11月29日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计5,502.70万元。

公司于2023年2月21日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项。

#### 五、节余募集资金的使用计划

为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）9,411.57万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金，支持公司主营业务的日常经营与发展。

本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟先将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

本次节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

上述资金划转完毕后，公司将注销相关的募集资金专户，届时对应的《募集资金三/四方监管协议》随之终止。

## 六、相关审议程序

经审议，董事会认为：鉴于公司首发募投项目已达到预计可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，同意公司对相关募投项目进行结项并将节余募集资金进行永久补充流动资金，用于支持公司主营业务的日常经营与发展。本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金符合公司生产经营的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

## 七、保荐机构意见

经审查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金进行永久补充流动资金事项已经第二届董事会第三十次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次募投项目结项及节余募集资金补流事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司实际经营需要。综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金进行永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金进行永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 金玉龙

金玉龙

张文召

张文召

